



基板実装参考パターン
尺度4/1

R o H S Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

尺度	10/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 SMP-PR-SMT(SB)
		石 '22.10.28 川	檜 '22.10.28 澤	山 '22.10.28 本	三 '22.10.28 村	
単位	mm	投 影 法				
日付	2022.10.28					図 番
						I-1036151

番号	部品名	材質	数量	処理	備考
3	中心コンタクト	リン青銅	1	Au	
2	絶縁体	テフロン	1	—	
1	シェル	黄銅	1	Au	

仕 様 書

品 名 SMP-PR-SMT (SB)

No. 1032458

図 番 I-1036151

定 格 1 参考規格 IEC 61169-44
 2 定格電圧 AC 170V
 3 定格周波数 40GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 使用温度範囲 -55℃～+125℃



項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
	材 質	(図番 : I-1036151)	
	仕上げ及び表示		
4 5 6 7	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ 以上
	耐電圧	AC 500V 1分間	異常のないこと
	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	内部導体間 : 6.0mΩ 以下 外部導体間 : 3.0mΩ 以下
	リターンロス	DC~26.5GHzまで 26.5GHzを超えて40GHzまで	17dB以上 10dB以上
8 9 10	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
	繰返し動作	1000回	異常のないこと
	結合力/離脱力	13N typ. / 2.2N typ.	

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成